

## Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Die Produktpalette umfasst ein-, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatten, flexible Leiterplatten und MCPCBs. Wir bieten einen schnellen Prototypenservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden Produktionszeit.

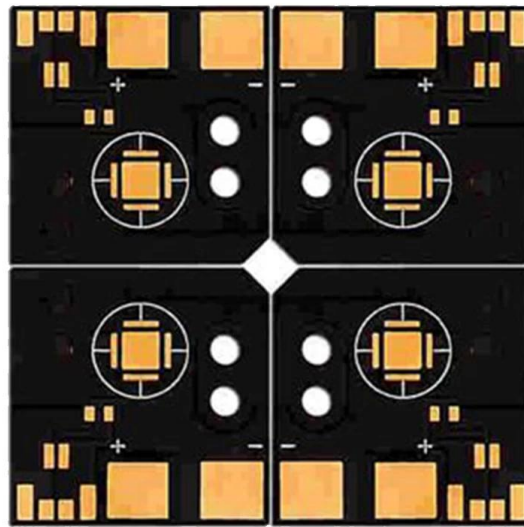
KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER DÜRFEN NICHT STECKEN

Packen Sie mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke und legen Sie die Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE AUF DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Immersion Gold Hersteller China](#)

## Produktbeschreibung

PCB P / N.	Q501805-A
Ebenenanzahl	2L
Material	Basiskeramik
Board thk	0,50 mm
Kupfer thk	1 / 1oz
Kleinste Lochgröße	1,6 mm
Anzahl der Löcher (Stk.)	4
Linie w / s	./.
Impedanzregelung. J / N (Tol%)	N.
Oberflächenveredelung	ENIG
Lötmaske Siebdruck	N / A
Einzelplatinengröße	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50
Panelisierung	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50; Anzahl der USV: 1
Besondere	N.
Routing / Stanzen	CNC



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[HEAVY COPPER BOARD Hersteller China](#)

**Unser Team**





**Zertifizierungen**



CICC INSPECTION CERTIFICATION



**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**

Certificate No: 16118Q10347R05

**We hereby certify that**

**O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED**

Credit No.: 61691591-000-07-17-2

Registration Add: ROOM 603D 6/F HANG PONG COMMERCIAL BUILDING, 31 TONKIN ST. CHEUNG SHA WAN, KL, HK

Business Add: 1313 Floor 13 Fortune Building, Danstai Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfils the requirements of the following standards

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

**Scope of certification**

Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018  
This certificate is valid during: February 27, 2018 -- February 26, 2021  
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Qualified mark	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	----------------	------------------------------	----------------

The certification registration scope shall include the production services scope which shall be covered by the relevant effective administrative permission and qualification permission required by the state. The effectiveness of this certificate shall be validated by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid when used together with the surveillance audit conclusion. The related information of this certification can be searched at the portal of the site of company www.cicc.com.cn.






**ZPMV2.E490354**  
**Wiring, Printed - Component**

For enhanced search functionality, please visit [UL's Family of Databases](#).  
Click on a product designation for complete information.

**Wiring, Printed - Component**

See General Information for Wiring, Printed - Components

**O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED**      4190354

Fortune Building, Nanheng West Road  
Room 1313  
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Cond Width		Min		Max		Min		Max			
Min	Edge	Cond	SS/Thk	Area DS/ Diam	Solder Limits	Dper	Temp	Flame	RoHS	C	
mm(in)	mm(in)	mil(mm)	DS	mm <sup>2</sup> (in <sup>2</sup> )	C	sec	C	Class	DSR	I	
<b>Hull-layer (mass laminate) printed wiring boards.</b>											
<b>O-LEADING-401</b>											
0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (0.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	-
<b>O-LEADING-407</b>											
0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	NI	-	-
<b>Hull-layer printed wiring boards.</b>											
<b>O-LEADING-408</b>											
0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) to 135	DS	50.8 (2.0)	260	10	130	V-0	NI	-	-
<b>Single layer printed wiring boards.</b>											
<b>O-LEADING-002</b>											
0.76 (0.03)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.7)	260	10	105	V-0	NI	-	-
<b>O-LEADING-003</b>											
0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.7)	260	10	130	V-0	▲	-	-
<b>O-LEADING-033</b>											
0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	-
<b>O-LEADING-205</b>											
0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	-
<b>O-LEADING-206</b>											
0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	-

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.  
Last updated on 2017-01-27

**SGS**

**Test Report**

No. CANEC1805164701      Date: 03 Apr 2018      Page 2 of 8

Test Results:      Test Part Description:

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	CAN18-051647.001	Green "PCB"

- Remarks:
- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
  - (2) MDL = Method Detection Limit
  - (3) ND = Not Detected (< MDL)
  - (4) "-" = Not Regulated

**RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU**

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Items	Limit	Unit	MDL	DET
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND

## Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-Leiterplattenhersteller
Lieferdetail	7-12 Tage



## FAQ

1. Wie sichert O-Leading die Qualität? ([Prototyp PCB Assembly Company China](#))

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Standortprüfgeräte und -werkzeuge. Z.B. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Der RMB in chinesischer Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies liegt ganz bei unseren Innovationen zur Kostensenkung, Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Vorteil in Bezug auf Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten?

Gängige FR4-, High-TG- und Halogen-freie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-basierte Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innen-Trockenfilm → Innen-Ätzen → Innen-AOI → Mehrfachbindung → Schichtaufbau Pressen → Bohren → PTH → Plattenbeschichtung → Äußerer Trockenfilm → Musterbeschichtung → Außenätzen → Äußere AOI → Lötmaske → Komponentenmarkierung → Oberflächenbeschaffenheit → Arbeitsplan → E / T → Sichtprüfung.